

제 1 교 시

※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. 룰(Rule)41/ 아이템(ITEM) 222
2. 골판지 상자의 스테인-홀 공정(Stein-hall Process)
3. 골판지 제조에 있어서 와프현상의 중요한 원인 5가지
4. 지기의 표면가공방법 5가지
5. 종이 또는 플라스틱 필름의 코팅방법을 결정하는데 고려해야할 Factor
6. 플렉소(Flexo) 인쇄기의 아니록스 롤(Anilox Roll)
7. 일반적인 인쇄 잉크의 건조 단계
8. 알.에프.아이.디 리벨(RFID : Radio Frequency Identification)
9. 플라스틱의 용해도 지수(Solubility Parameter)
10. 유리의 그리피스 플로(Griffithis Flow)
11. 디.티.알 캔(DTR : Draw-Thin-Redraw Can)
12. 지능형 포장(Intelligent Packaging)
13. G-factor

제 2 교 시

※ 다음 7문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)

1. 골판지의 골의 종류 및 특성과 마이크로 골(Micro flute)에 대하여 설명하십시오.
2. 무균포장에 사용되는 포장재의 살균방법에 대하여 설명하십시오.
3. 유통과정에서 포장화물의 신뢰성 평가를 위한 시험방법과 그 목적에 대하여 설명하십시오.
4. 최근 논란이 되고 있는 유니트로드 시스템에 정합하는 국제적 추세와 이의 대응 방안에 대하여 기술하십시오.
5. 플라스틱 필름에 있어서 히트셀(Heat seal)에 영향을 미치는 주요한 Factor 5가지 이상 설명하십시오.
6. 베리어 프리 패키지(Barrier free package)와 유니버설 디자인(Universal design)의 개념과 포장단계에 있어서 필요한 기능에 대하여 설명하십시오.
7. 용기성형 방법중 중공성형(Direct Blow)에 대하여 설명하십시오.

